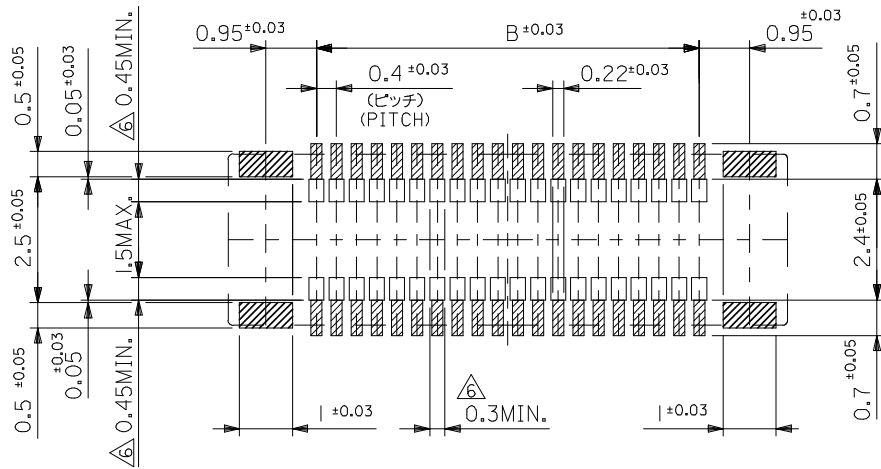


25.5	23.6	27.1	51338-1274	51338-1209	120
21.5	19.6	23.1	51338-1074	51338-1009	100
19.5	17.6	21.1	51338-0974	51338-0909	90
17.5	15.6	19.1	51338-0874	51338-0809	80
15.5	13.6	17.1	51338-0774	51338-0709	70
13.5	11.6	15.1	51338-0674	51338-0609	60
11.5	9.6	13.1	51338-0574	51338-0509	50
9.5	7.6	11.1	51338-0474	51338-0409	40
8.3	6.4	9.9	51338-3474	51338-0349	34
7.5	5.6	9.1	51338-0374	51338-0309	30
6.7	4.8	8.3	51338-2674	51338-0269	26
6.3	4.4	7.9	51338-2474	51338-0249	24
5.9	4.0	7.5	51338-2274	51338-0229	22
5.5	3.6	7.1	51338-0274	51338-0209	20
3.9	2.0	5.5	51338-9974	51338-0129	12
C	B	A	EMBOSSED TAPE PKG.	MATERIAL No.	CKT.
			ORDER No. オーダー番号		

REVISED EC NO.: J2009-0301 DRWN: MWABEI 2008/08/27 CHKD: THARUYAMA 2008/08/28 APPR: NUKITA 2008/08/28	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE ---	DESIGN UNITS METRIC	MODEL NO.	
	10 UNDER	±---	DRAWN BY M. NINOMIYA	DATE 2004/03/17	TITLE 0.4 B-TO-B REC ASSY HGT=1.5 J-BEND TAIL -LEAD FREE-			
	10 OVER 30 UNDER	±---	CHECKED BY K. TOJO	DATE 2004/03/17	MATERIAL NO.			
	30 OVER	±---	APPROVED BY M. SASAO	DATE 2004/03/17	DOCUMENT NO. SD-51338-003			
REV	DESCRIPTION	ANGULAR	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE			SHEET NO. 1 OF 2



参考基板レイアウト (マウント面)
P.C.BOARD PATTERN DIMENSION (REFERENCE)
(MOUNTING AREA)

注記 NOTES:

1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング: 液晶ポリマー (LCP) ガラス充填 UL94V-0 (黒)
HOUSING: LIQUID CRYSTAL POLYMER (GLASS FILLED)
UL94V-0 (COLOR: BLACK)
ターミナル: リン青銅 (t=0.15)
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
金具: リン青銅 (t=0.15)
FITTING NAIL: PHOSPHOR BRONZE (t=0.15)
2. メッキ仕様 PLATING
ターミナル TERMINAL
金メッキ 0.2マイクロメートル以上 (コンタクト部)
GOLD 0.2MICROMETER MINIMUM (CONTACT AREA)
金メッキ 0.4マイクロメートル以下 (テール部)
GOLD 0.4MICROMETER MAXIMUM (TAIL AREA)
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5マイクロメートル以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.5MICROMETER MINIMUM
*コンタクト部とテール部はニッケルメッキによって分断されている金メッキです。
DIVIDE INTO PARTS THE GOLD PLATING OF THE CONTACT AND THE TAIL PART BY THE NICKEL PLATING.
金具 FITTING NAIL
錫メッキ 1.0 マイクロメートル以上
TIN PLATING 1.0 MICROMETER MINIMUM
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0 マイクロメートル以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM
3. (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
4. 嵌合相手: 55909シリーズ
MATE WITH: 55909 SERIES.
5. テール平坦度は、0.08以下
テール及び金具の平坦度は、0.1以下
TAIL COPLANARITY TO BE 0.08MAXIMUM
TAIL AND FITTING NAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAXIMUM
6. 同一回路以外のパターン書込み禁止範囲を示す。
NO PRINT CIRCUIT AREA OTHER THAN THE SAME CIRCUIT.
7. 本製品は 51338-***3 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 51338-***3.

REVISED EC NO.: J2009-0301 DRAWN: MABEI 2008/08/27 CHKD: THARUYAMA 2008/08/28 APPR: NUKITA 2008/08/28	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		51338-***9		MODEL NO.	
	10 UNDER	±---	DRAWN BY	DATE	SCALE	DESIGN UNITS	THIRD ANGLE PROJECTION	
	10 OVER 30 UNDER	±---	M. NINOMIYA	2004/03/17	---	METRIC	0.4 B-TO-B REC ASSY HGT=1.5 J-BEND TAIL -LEAD FREE-	
	30 OVER	±---	K. TOJO	2004/03/17	molex		MOLEX INCORPORATED	
ANGULAR	±---°	APPROVED BY	DATE	MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE SHEET 1		M. SASAO 2004/03/17		SD-51338-003		SHEET NO. 2 OF 2
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION								